

● WLP-6-01 パッケージ許容損失

WLP-6パッケージにおける許容損失特性例となります。

許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

1. 測定条件(参考データ)

測定条件: 基板実装状態

雰囲気: 自然対流

実装: Pbフリーはんだ

実装基板: 銅箔4層基板40mm×40mm(片面1600mm²)
に対して銅箔面積

1層目: 約50%_各リード接続

2層目: 約50%_各リード接続

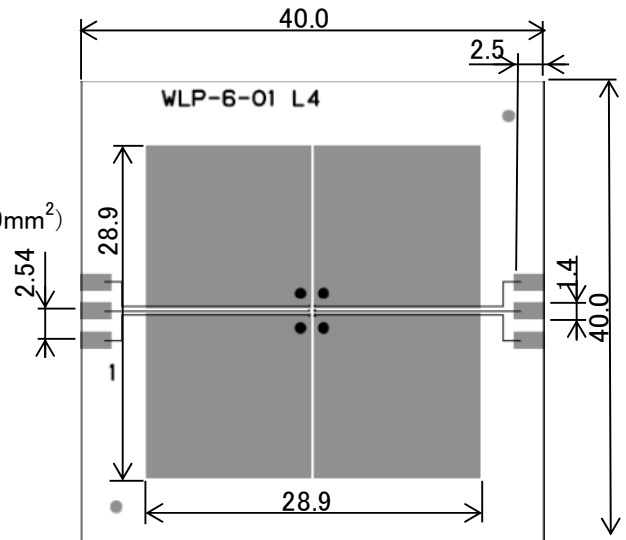
3層目: 約50%_各リード接続

4層目: 約50%_各リード接続

基板材質: ガラスエポキシ(FR-4)

板厚: 1.6mm

スルーホール: ホール径 0.8mm 4個



評価基板レイアウト(単位:mm)

2. 許容損失 - 周囲温度特性

基板実装($T_{jmax} = 125^{\circ}C$)

周囲温度(°C)	許容損失Pd(mW)	熱抵抗(°C/W)
25	700	142.86
85	280	

